

2006年11月2日

2007年3月期
中間決算説明会

東京エレクトロン デバイス株式会社

2007年3月期中間(連結)業績

(単位:百万円)

	2006年3月期		2007年3月期		増減率 (%)
	中間	百分比%	中間	百分比%	
売上高	42,622	100.0	45,625	100.0	7.0%
売上総利益	5,579	13.1	5,901	12.9	5.8%
営業利益	1,438	3.4	1,550	3.4	7.8%
経常利益	1,218	2.9	1,419	3.1	16.4%
当期純利益	716	1.7	841	1.8	17.4%
1株当たり中間純利益	7,790.37円		9,146.61円		
R O E	10.0%		10.9%		
従業員数	563人		574人		

2007年3月期中間(連結) 資産

(単位:百万円)

科目	2006年3月期 中 間	2007年3月期 中 間	増減額
現預金	1,110	793	317
受取手形・売掛金	22,699	17,478	5,220
たな卸資産	12,457	16,407	3,949
その他流動資産	694	721	27
有形固定資産	743	699	44
無形固定資産	201	144	56
投資その他の資産	1,404	1,476	72
資産計	39,311	37,721	1,590

2007年3月期中間(連結) 負債・純資産

(単位:百万円)

科目	2006年3月期 中 間	2007年3月期 中 間	増減額
買掛金	11,772	11,177	595
短期借入金	5,084	2,478	2,606
その他流動負債	1,936	2,440	504
長期借入金	3,000	3,000	-
その他固定負債	2,902	2,932	29
負債計	24,697	22,029	2,667
資本金	2,495	2,495	-
資本剰余金	2,054	2,054	-
利益剰余金	10,061	11,154	1,093
評価・換算差額等	2	13	16
純資産計	14,614	15,691	1,076
負債・純資産計	39,311	37,721	1,590

2007年3月期中間(連結) キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

	2006年3月期 中 間	2007年3月期 中 間	増減額
営業キャッシュ・フロー	511	386	898
投資キャッシュ・フロー	136	109	27
財務キャッシュ・フロー	193	490	684
現金及び現金同等物 中間期末残高	1,110	793	317

2007年3月期中間(連結) 品目別売上高

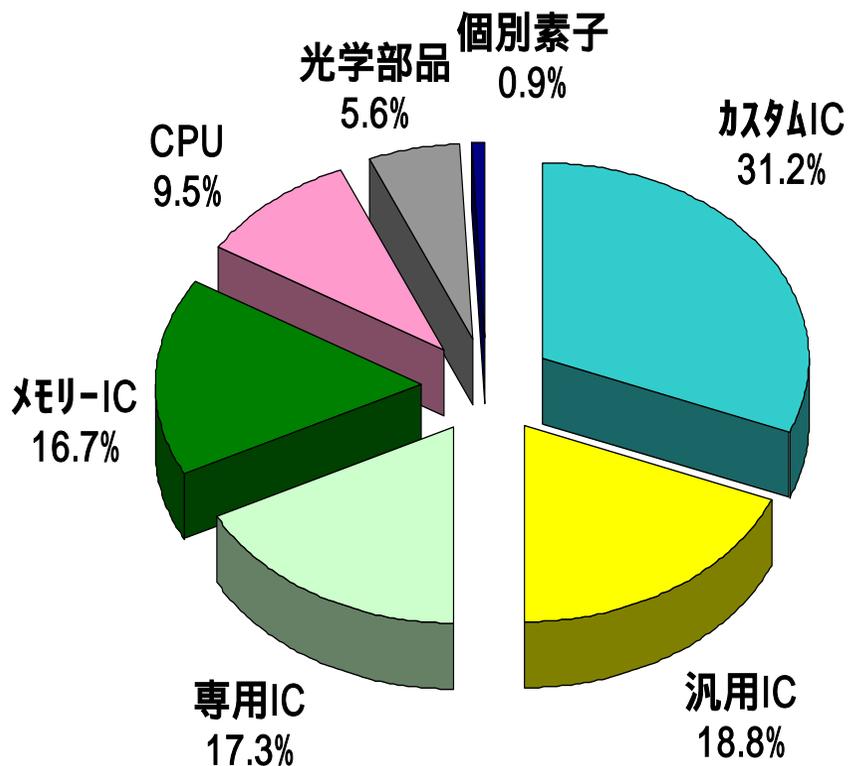
(単位:百万円)

品目*	2006年3月期中間		2007年3月期中間		増減率 (%)
	売上高	構成比%	売上高	構成比%	
半導体製品	37,577	88.2	40,640	89.1	8.2
ボード製品	1,891	4.4	1,638	3.6	13.4
ソフトウェア	1,488	3.5	2,187	4.8	47.0
一般電子部品	1,665	3.9	1,159	2.5	30.4
合計	42,622	100.0	45,625	100.0	7.0

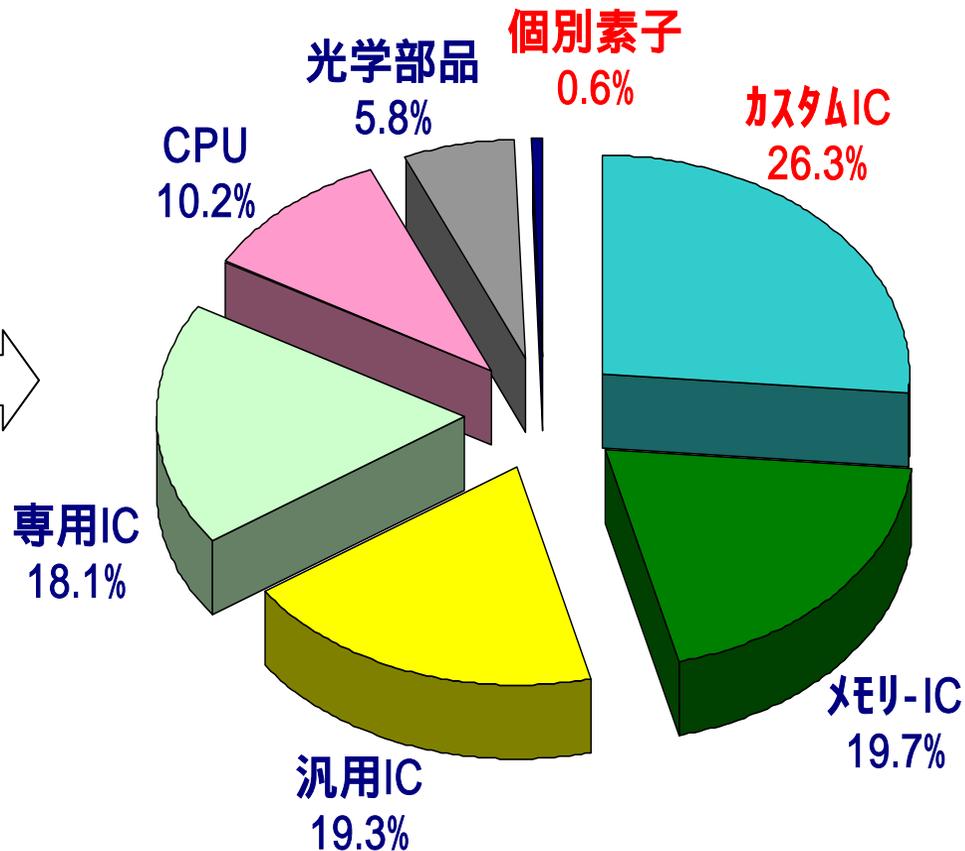
* 品目についての説明は、P.23～P.25をご参照ください。

2007年3月期中間(連結) 半導体製品売上構成比

< 2006年3月期中間 >



< 2007年3月期中間 >

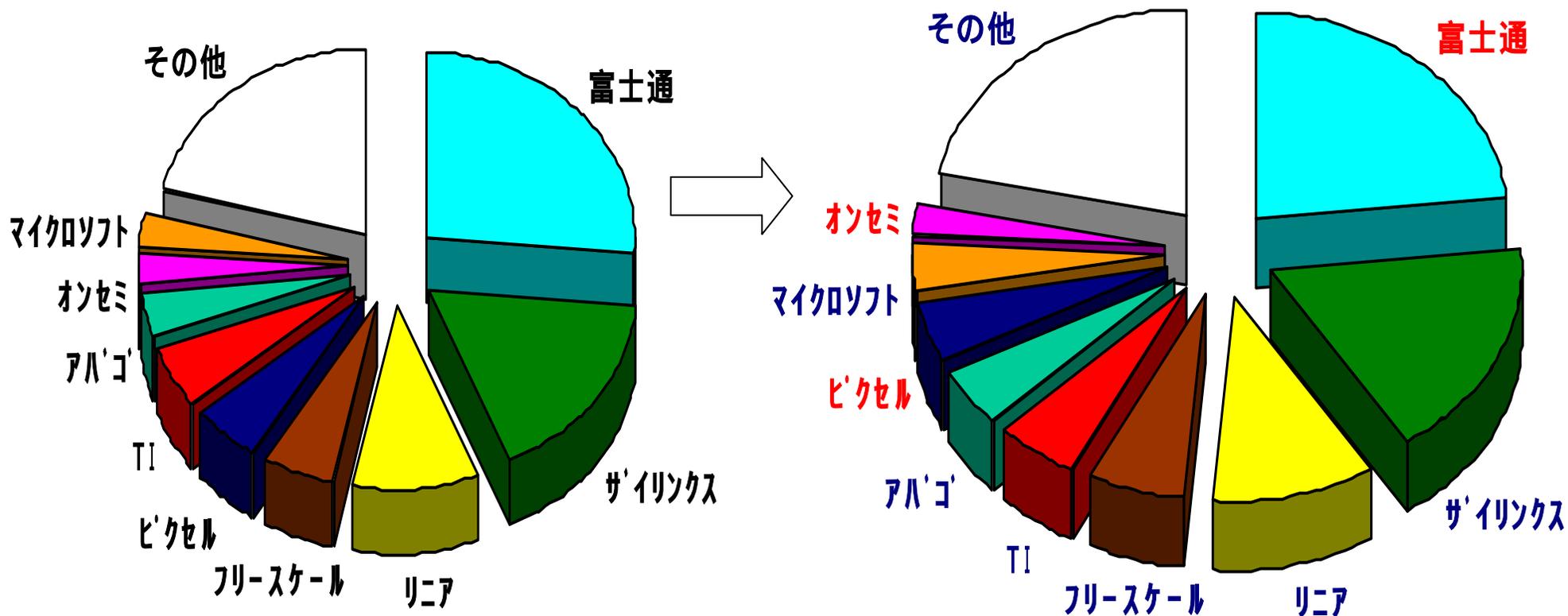


* 品目についての説明は、P.23 P.24をご参照ください。

2007年3月期中間(連結) 商品別売上構成比

< 2006年3月期中間 >

< 2007年3月期中間 >



注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

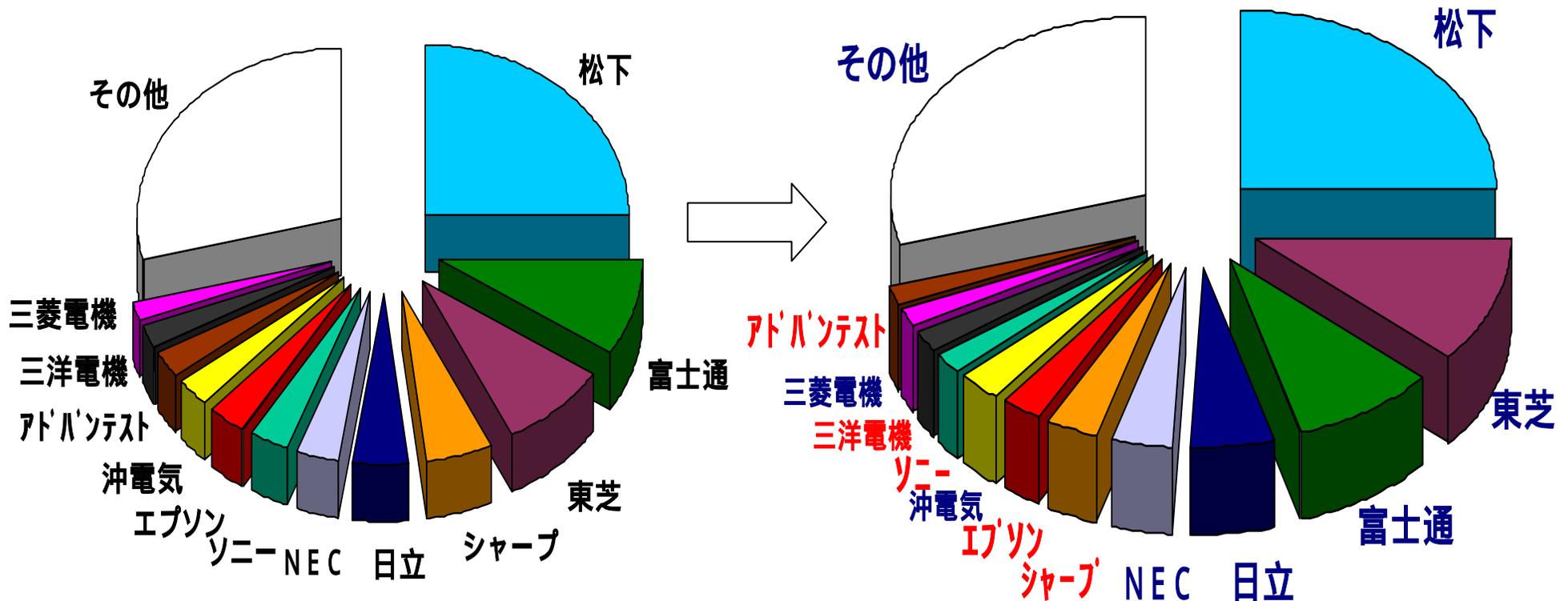
2007年3月期中間(連結) 主要商品別売上増減要因

仕入先名	増減率	要 因
富士通(株)	5%	民生機器向けASIC減少
ザイリンクス社	8%	産業機器向けを中心に回復
リニアテクノロジー社	16%	全ての分野で伸長
フリースケール・セミコンダクタ社	20%	通信インフラ向け伸長
TI社	4%	基地局向け好調
アバゴ・テクノロジー社	31%	商権拡大が寄与
ピクセルワークス社	5%	LCD方式プロジェクトの市場シェア減少
マイクロソフト社	46%	POS端末向けを中心に大幅に伸長
開発ビジネス	27%	富士通ASICの設計受託が伸長

2007年3月期中間(連結) 顧客別売上構成比

< 2006年3月期中間 >

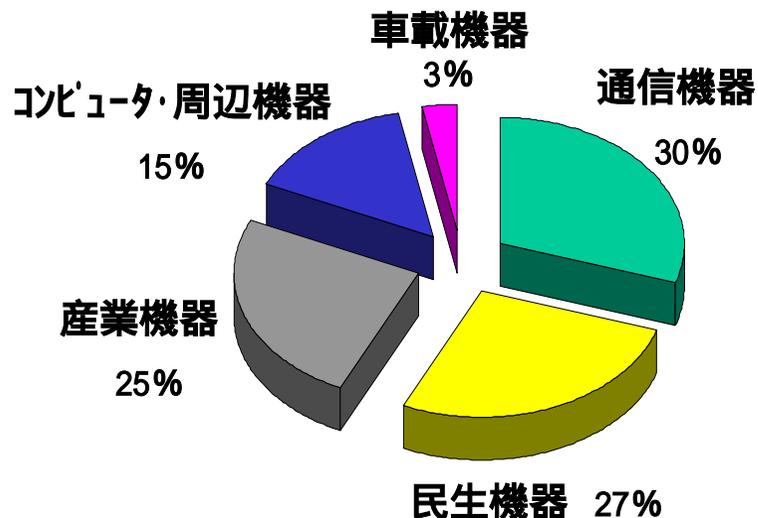
< 2007年3月期中間 >



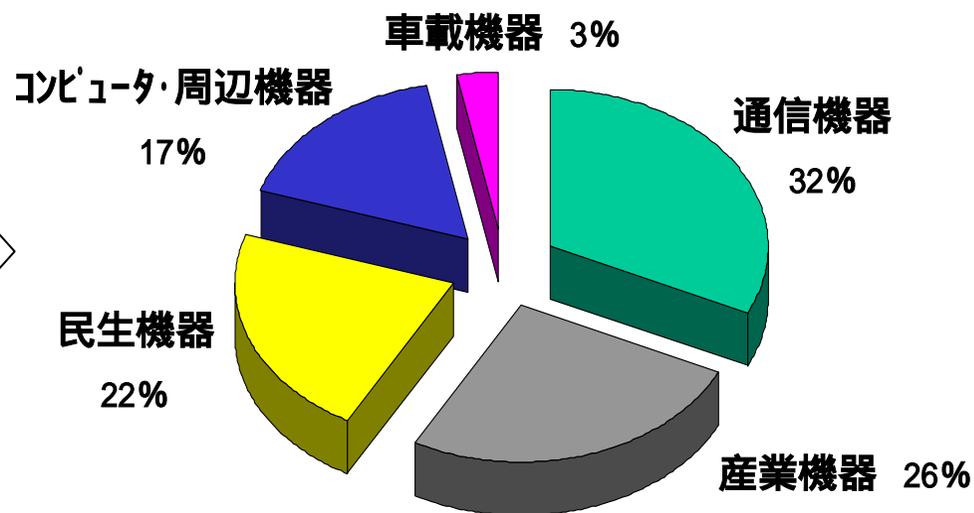
注) 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2007年3月期中間(連結) 用途別売上構成比

< 2006年3月期中間 >



< 2007年3月期中間 >



用途	主なアプリケーション
通信機器	携帯電話、交換機、基地局、インターネット接続機器
産業機器	セキュリティ監視機器、医療機器、放送機器、テスター、半導体製造装置
民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、液晶・プラズマTV、DVD、携帯音楽端末
コンピュータ・周辺機器	プリンター、液晶プロジェクタ、POS、PC、メモリカード
車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ

海外ビジネスについて

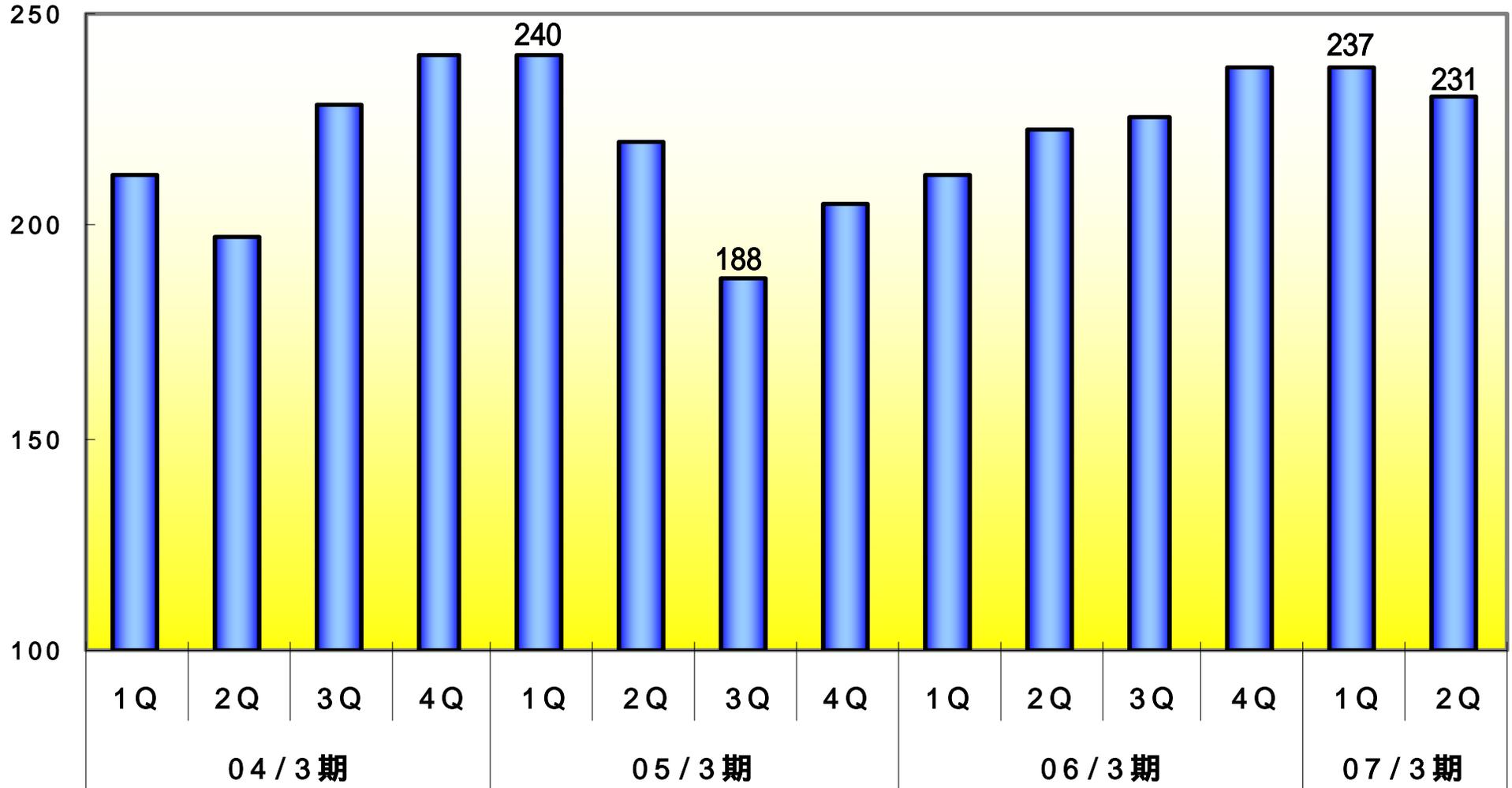
東京エレクトロン デバイス香港

	2006年3月期	2007年3月期		
	通期実績	上期実績	下期計画	通期計画
売上高	28億円	29億円	31億円	60億円

今期の業績予想について

電子部品 受注額推移

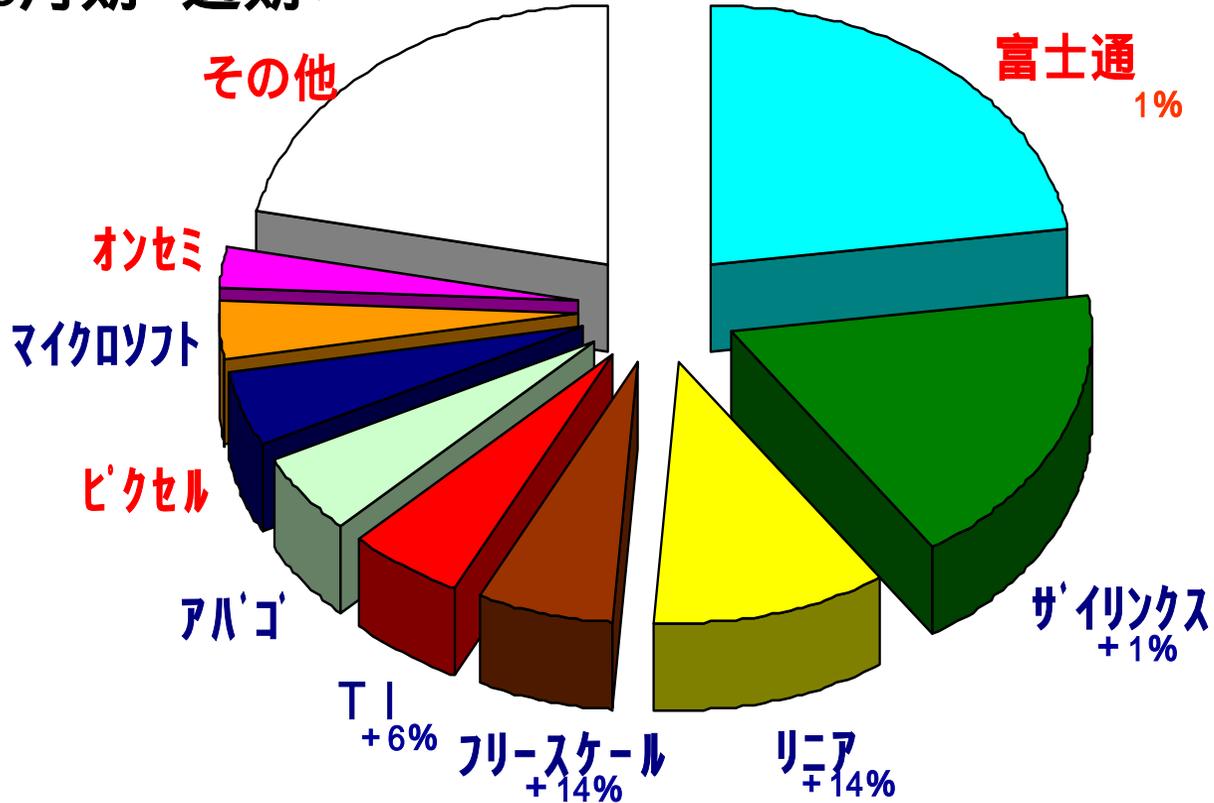
(億円)



注) 2006年3月期より連結決算を開始しており、2006年3月期以降は、連結受注額を記載しております。

電子部品 主要商品別 売上構成見込み

< 2007年3月期 通期 >



注) 上記見込みは、各仕入先の業績には連動いたしません。
 数字は、前年比増減見込みを記載しております。
 社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

コンピュータ・ネットワーク(CN)事業

(2006年10月1日 東京エレクトロン(株)から事業承継)

事業分野	主な用途・機能	主要仕入先	下期売上見込み
ネットワーク機器	インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)、 企業向けネットワークシステム構築機器など	Extreme F5Networks	33億円
ストレージ機器	SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など	Brocade Emulex	40億円
ミドルウェア	データベース、ログ解析など	Oracle Sensage	12億円



F5Networks



Brocade

注)社名は、敬称を省略し略称を使用させていただいております。

2007年3月期 連結 業績予想

(単位:百万円)

科 目	2006年3月期 通期実績	2007年3月期 通期予想	通期対前年 増減率
売上高	88,290	100,000	13.3%
経常利益	2,630	3,000	14.1%
当期純利益	1,537	1,760	14.5%
1株当たり 当期純利益	16,525.92円	17,777.78円	
1株当たり配当金	6,000円	6,000円	
R O E	10.5%	9.9%	

2007年3月期の業績予想は、コンピュータ・ネットワーク(CN)事業を加えた数値です。

今期の活動方針

商社ビジネス

- 新商品の導入
- 高付加価値商品の販売促進
- 産業機器分野への販売活動に注力

開発ビジネス

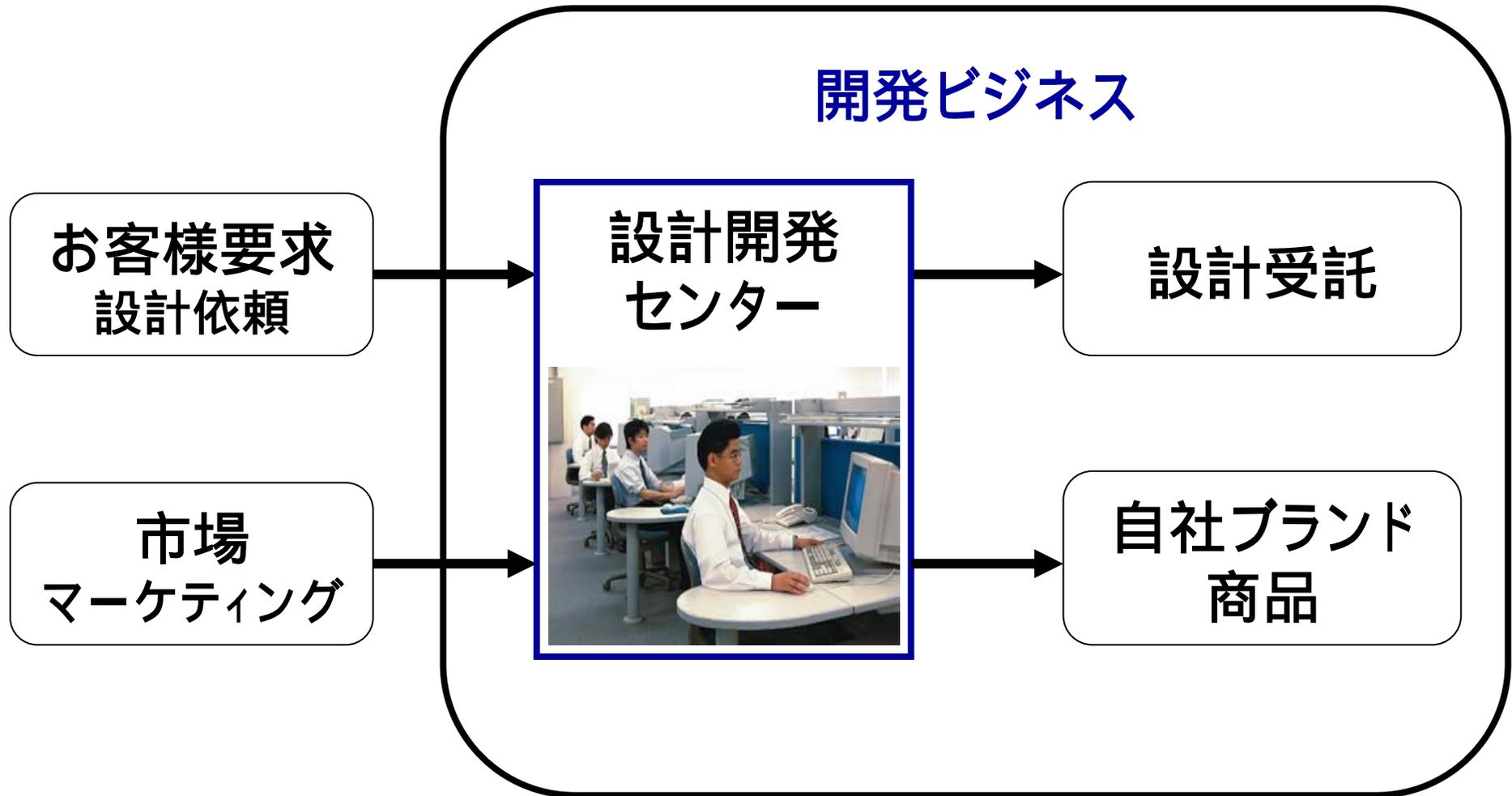
- FPGAを中心とした設計受託業務の受注拡大
- 産業機器向け自社ブランド商品の開発

開発ビジネスについて

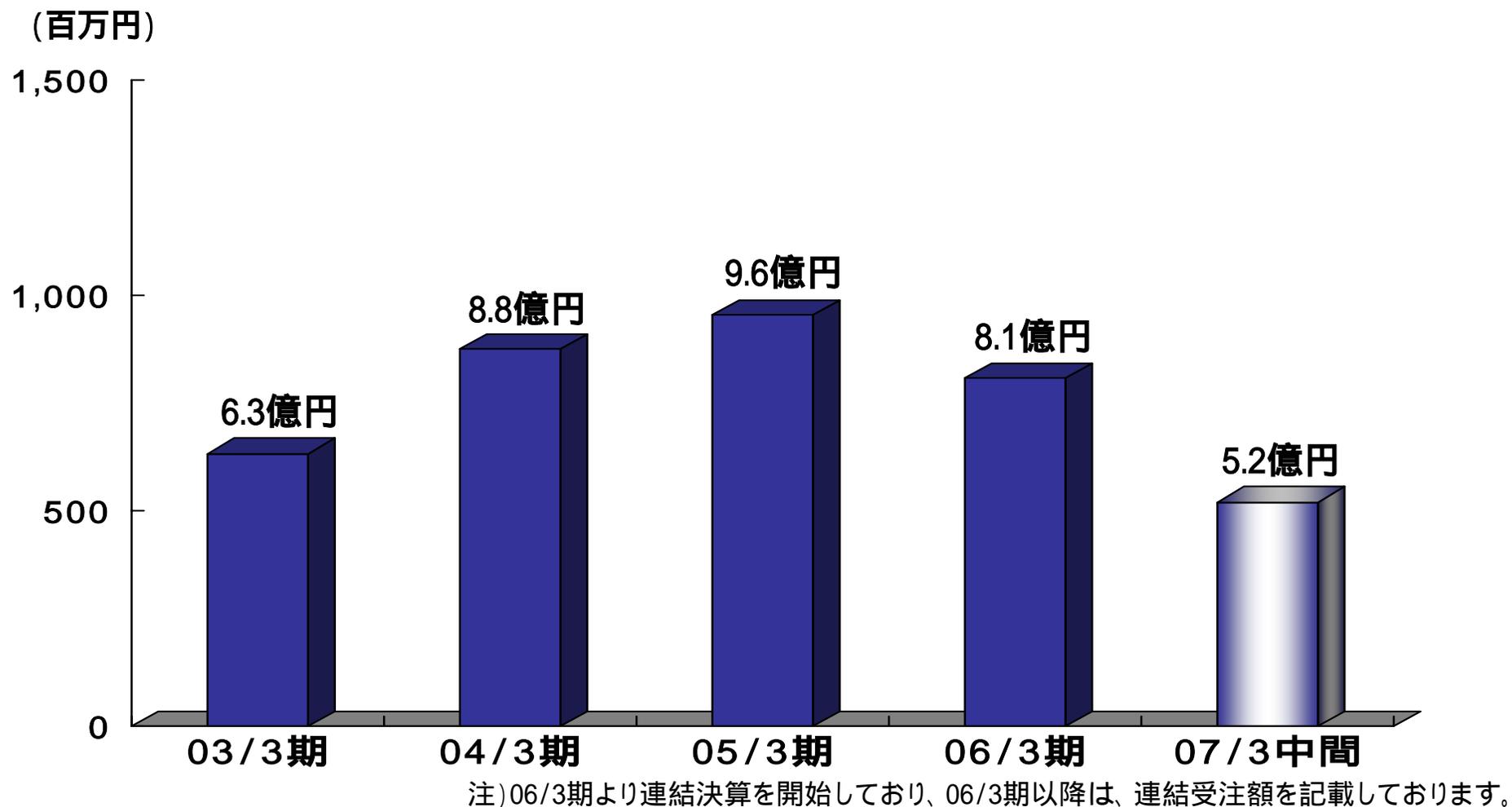
inrevium

(インレビウム)

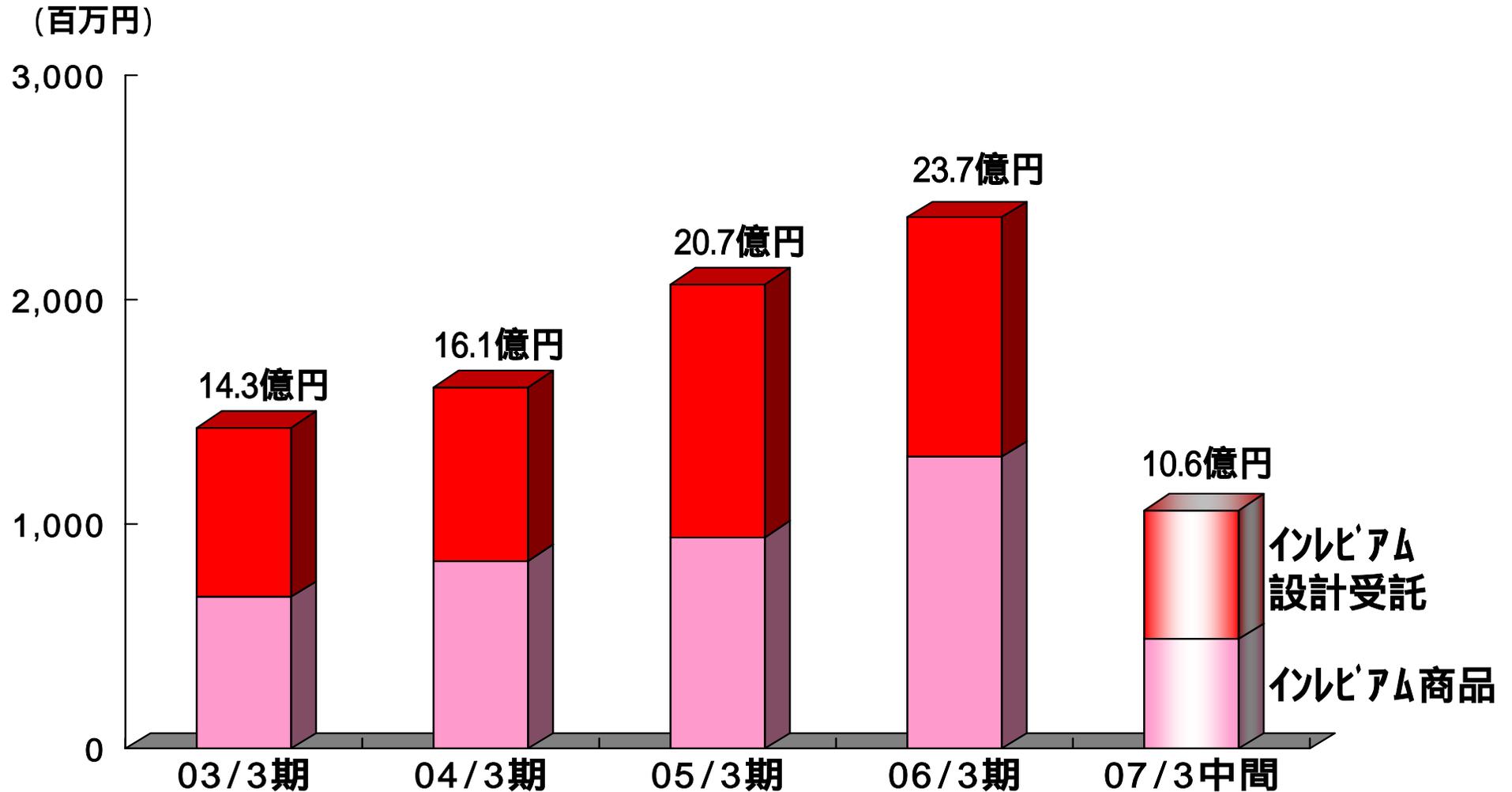
高付加価値事業への取組み



富士通ASIC開発 受注額推移



インレビウム受注額推移



注)06/3期より連結決算を開始しており、06/3期以降は、連結受注額を記載しております。

品目別仕入先名

	品目	主な仕入先名
半導体製品	カスタムIC	富士通(株)、ザ・リンクス社
	メモリーIC	富士通(株)、IDT社、ラムロンインターナショナル社
	汎用IC	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、TI社
	専用IC	インフィニオン社、コネクサントシステムズ社、フリースケール・セミコンダクター社、富士通(株)、ピクセルワークス社、ザ・リンク・セミコンダクター社、インビーム
	CPU	フリースケール・セミコンダクター社、富士通(株)、TI社
	光学部品	アバゴ・テクノロジー社
	個別素子	オン・セミコンダクター社
ボード製品		インテル社/ダイアロジック製品、インビーム
ソフトウェア		マイクロソフト社、インビーム
一般電子部品		コーセル(株)、(株)デジタル

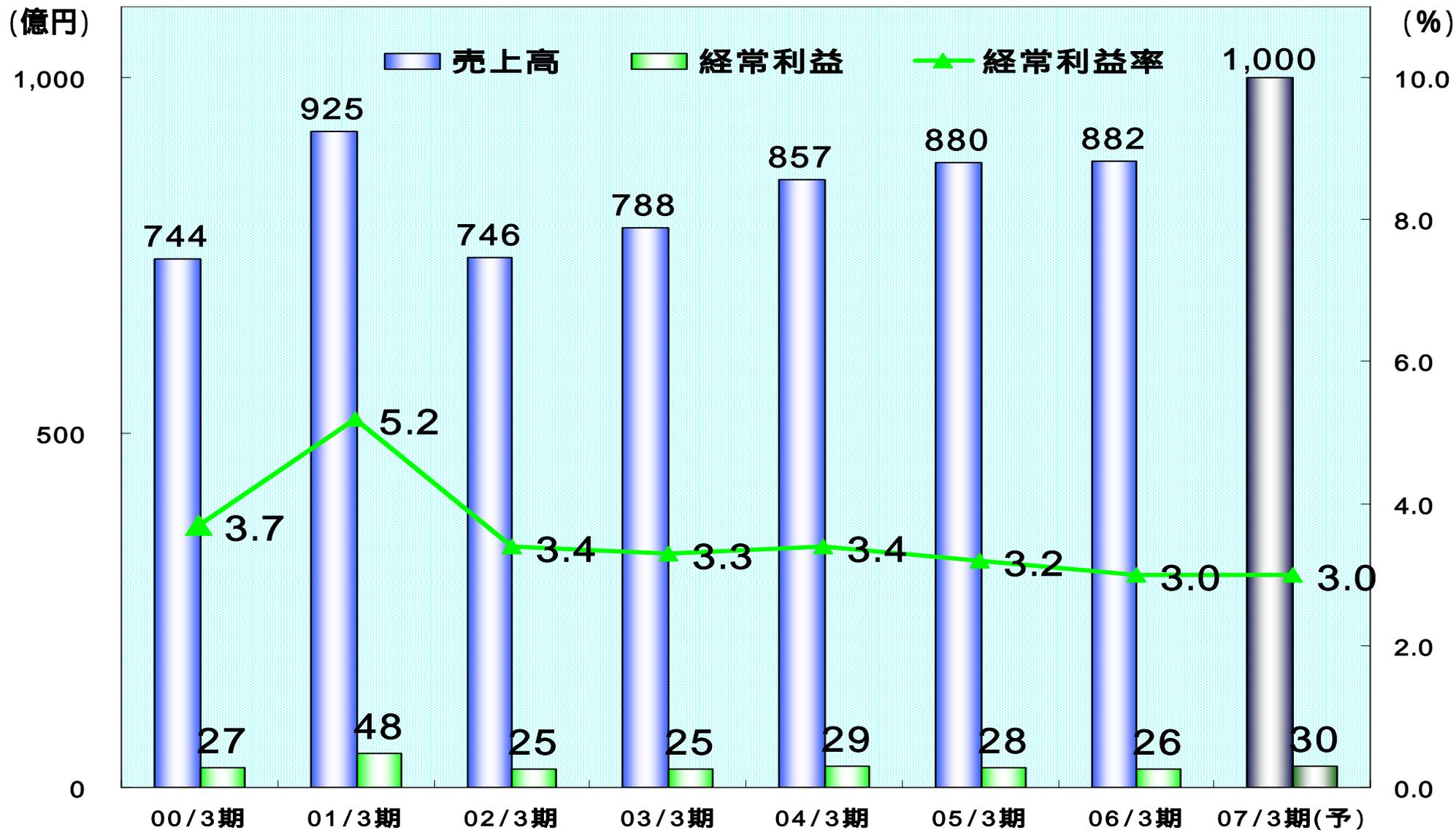
用語説明(1)

半導体製品	主な取扱商品	機能
カスタムIC	ASIC(富士通株) PLD(サイリクス社)	お客様の仕様に応じて作られる固有IC
メモリーIC	DRAM、SRAM フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
汎用IC	汎用リニアIC(アナログIC) 汎用ロジックIC	色々な用途に共通に使用されるIC
専用IC	画像処理用IC 通信用・ネットワーク用IC	特定用途用に作られた専用IC
CPU	マイクロプロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品

用語説明(2)

ボード製品		プリント配線基板の上にIC、電源、コネクタなどの部品を実装した製品
ソフトウェア		産業機器に組み込まれるマイクロソフト社のOSを中心に販売(PC用以外)
一般電子部品		機器間を接続するコネクタやケーブル、液晶表示部品、電源など、電子機器には不可欠な周辺部品

業績推移・計画



資料取扱い上の注意

このプレゼンテーションで述べられている将来の当社事業に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。

当社の参画するエレクトロニクス業界は変化のスピードが大変速く、また、世界経済、半導体市況など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、今後当社の業績見通しが本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。